

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-074

生益电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，生益电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“生益电子”)编制了截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金金额、资金到位时间情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)7号)同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元(不含税)，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。上述募集资金已于2021年2月19日全部到位，该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字【2021】21000250047号)。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 前次募集资金专户存储情况

截至2025年9月30日，公司前次募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日金额	注销日期
中国建设银行 股份有限公司 东莞万江支行	44050177610 809987777	募集资金 专户	718,110,077.48		2023年11 月14日
交通银行股份	48300761101	募集资金	104,232,887.50		2022年6月

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日金额	注销日期
有限公司东莞分行	3000154770	专户			29 日
中信银行股份有限公司东莞新城支行	8110901014301254600	募集资金专户	333,351,879.93		2024 年 7 月 26 日
中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010021329200666688	募集资金专户	199,488,779.91		2021 年 12 月 28 日
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881686681688869	募集资金专户	637,865,373.76	175,275,500.67	
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881681686868836	一般结算户		募集资金专项账户变更为一般结算户 [注 2]	
合计			1,993,048,998.58 [注 1]	175,275,500.67	--

注 1：公司募集资金净额 1,974,938,921.10 元与初始存入金额 1,993,048,998.58 元差异 18,110,077.48 元，差异金额原因如下：募集资金置换预先投入募投项目已支付的发行费用 7,468,568.03 元，募集资金到账前尚未支付的发行费用 10,641,509.45 元。

注 2：广发银行股份有限公司东莞城区支行银行账户 9550881681686868836 系吉安生益电子有限公司于 2022 年 1 月 27 日开立用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”的募集资金专项账户。2025 年 3 月 26 日经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议同意，2025 年 5 月 12 日经 2024 年年度股东大会审议同意，“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”的募集资金全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”。因涉及募集资金投资项目变更和项目实施主体变更，于 2025 年 6 月 20 日公司、公司全资子公司吉安生益电子有限公司、保荐机构东莞证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分行签署了《〈募集资金专户存储三方监管协议〉之解除协议》，协议约定自协议解除之日起，原账号为 9550881681686868836

的募集资金专项账户变更为一般结算户。

二、前次募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	2,066,240,880.00
减：发行费用（不含税）	91,301,958.90
实际募集资金净额	1,974,938,921.10
减：募投项目累计使用金额	1,569,391,271.60
其中：以前年度已使用金额	1,362,434,333.20[注 1]
本期募投项目使用金额	206,956,938.40
减：暂时补流	300,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	69,727,851.17
募集资金银行账户余额	175,275,500.67

注 1：以前年度已使用金额 1,362,434,333.20 元与 2024 年募集资金存放与使用情况鉴证报告中募投项目累计使用金额 1,513,523,968.13 元存在差异，系由于募集资金投资项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”变更为“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”，原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用前次募集资金 1,569,391,271.60 元，募集资金余额为 475,275,500.67 元，其中：募集资金银行存款余额为 175,275,500.67 元，未到期理财产品金额为 0.00 元，暂时补充流动资金金额为 300,000,000.00 元。

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金投资项目的募集资金投资项目调整及变更情况

1、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的议案》，同意调整公司募投项目“东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目”、“研发中心建设项目”投资结构和投资总额。具体详见公司 2021 年 3 月 15 日披

露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2021-003）。

公司于2022年3月11日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，同意公司募投项目“研发中心建设项目”、“东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目”调整投资总额和内部投资结构。具体详见公司2022年3月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-008）。

公司于2023年3月24日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。同意公司募投项目“研发中心建设项目”调整投资总额和内部投资结构。具体详见公司2023年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2023-017）。

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。同意公司募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”调整投资总额和内部投资结构。具体详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2023-024）。

2、关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的公告》。鉴于研发中心建设项目已达到可使用状态，研发项目已完成并具备批量制作能力，该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用，同意公司调整研发中心建设项目投资规模并结项。具体详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的公告》（公告编号：2024-047）。

公司于2025年10月28日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十

八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的公告》。鉴于东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目（以下简称“东城工厂四期项目”）已达到可使用状态，该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用，同意公司调整东城工厂四期项目内部投资结构并结项。具体详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的公告》（公告编号：2025-061）。

3、关于部分募集资金投资项目延期

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 6 月延长至 2025 年 12 月。具体详见公司 2024 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。

4、关于部分募集资金投资项目变更和实施主体变更情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，监事会和保荐机构发表了明确同意意见。公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”（以下简称“原项目”）的募集资金全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”（以下简称“新项目”），项目实施主体由吉安生益电子有限公司变更为生益电子股份有限公司。具体详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-014）。

4.1 本次部分募集资金投资项目变更和实施主体变更情况

结合近年来市场环境和行业发展趋势的变化，以及公司近两年来的投资项目情况和产能布局规划，为提高募集资金的使用效益，维护全体股东利益，原项目投资节奏放缓，公司将原项目的拟投入募集资金 63,786.54 万元全部变更用于新项目，不足部分由公司自有资金和自筹资金支付。本次拟变更用途的募集资金占募集资金总额的 30.87%。本次变更不构成关联交易，具体情况如下：

内容	调整前	调整后
项目名称	吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目	智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期
实施主体	吉安生益电子有限公司	生益电子股份有限公司
募投项目投资总额（万元）	119,841.41	100,035.00
拟投入募集资金金额（万元）	63,786.54	63,786.54

截至 2025 年 6 月 20 日，公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户。

4.2 本次部分募集资金投资项目变更的原因

原项目方案中，计划实施主体为公司全资子公司吉安生益电子有限公司，计划通过在吉安工厂新建 PCB 生产基地、增加生产设备等来扩大多层印制电路板产能，生产汽车电子、服务器等领域中高端大批量产品，解决现有产能瓶颈。

2021 年公司首次公开发行股票，基于当时外部市场环境预测汽车电子领域将呈现稳定的增长趋势，Prismark 预测 2019-2023 年汽车电子市场年均增长率将会达到 8.09%，显著高于所有下游行业市场规模的平均增长率，公司规划原项目定位为汽车电子领域产品。随着市场环境的持续快速变化，2023 年在市场形势不确定的大环境影响下，印制电路板产业短期需求增速承压，2023 年公司调整原项目的内部投资结构和投资总额，并将项目的一部分产能调整定位为生产汽车电子、服务器等领域中高端大批量产品。近年来，汽车电子市场规模增长趋缓，根据 Prismark 统计，2021-2024 年汽车电子市场规模实际平均增速 3.98%，其中 2024 年比 2023 年下降 4.96%；在汽车 PCB 市场规模方面，继 2021-2022 年汽车 PCB 市场规模快速增长后，2023 年汽车 PCB 市场规模比 2022 年下降 3.33%，2024 年比 2023 年仅增长 1.69%。同时，根据 Prismark 数据，汽车 PCB 市场规模 2023-2028F 年平均复合增长率预测为 4.7%，低于 2023-2028F 全球 PCB 市场规模年平均复合增长率 5.4%。以及汽车电子产品领域竞争激烈，技术门槛相对较低，导致汽车电子产品整体价格下降，行业竞争格局以及下游市场需求较原项目规划时均发生了显著变化，以及国际贸易格局的变化，项目进展放缓，公司需要积极应对宏观经济上可能存在的不利因素，结合战略规划进一步论证对原项目的规划和适时推进项目实施。

鉴于宏观环境和行业发展的快速变化，特别是人工智能技术的快速发展，推动 AI 相关产业链迅速发展，以及低空经济、高端通信网络等领域的快速发展，全球经济产业链重构，公司策划和制定 2025 年-2029 年新一轮发展战略，积极调整产品规划和产能布局，细化各下属工厂产品定位和产能规划，对于原项目将结合市场和行业变化趋势和集团统筹规划进一步研究论证工厂定位与推进计划。同时，东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目在 2024 年、2025 年产能持续提升，短期内能够满足公司在通信网络、服务器、汽车电子等应用领域的营销布局；新筹划的智能算力中心高多层高密互连电路板项目将能够有效利用现有的资源配套优势，快速满足智能算力领域市场需求。原项目规划产能 100 万平方米/年，如按原计划进度实施扩大生产规模，有可能造成募投项目现阶段产能利用率不高，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响，不利于募集资金的使用效率。

为更好地满足公司业务发展的需要，公司在对印制线路板行业以及智能算力等领域市场需求、技术需求充分调研评估的基础上，“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”的实施计划如下：计划实施主体为生益电子股份有限公司，计划在公司东莞制造基地现有厂房投资智能算力中心高多层高密互连电路板项目，计划建设期 1 年以内，预计在 2025 年试生产。

4.3 本次部分募集资金投资项目变更对公司的影响

本次调整部分募集资金投资建设项目和实施主体是公司根据市场环境、行业发展趋势以及公司近两年来的投资项目情况和产能布局规划做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至 2021 年 2 月 19 日，公司已实际投入资金 76,222,443.77 元。

2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 76,222,443.77 元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081 号”《生益电子股份有限

公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之核查意见》。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司从募集资金专户中实际转出 76,222,443.77 元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

（五）闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年3月7日，公司已将暂时补充流动资金5亿元全部归还。

2022年3月11日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年2月21日，公司已将暂时补充流动资金5亿元全部归还。

2023年10月26日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年10月15日，公司已将暂时补充流动资金3.5亿元全部归还。

2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 9 月 30 日，具体情况如下：

单位：人民币万元

审批时间	补流金额	已归还金额	待归还金额	归还截止日期
2024. 10. 28	40, 000	10, 000	30, 000	2025. 10. 27

截至 2025 年 10 月 23 日，公司已将暂时补充流动资金 4 亿元全部归还。

公司在上述公告额度和期限范围内滚动使用闲置募集资金，公司已按相关议案要求归还前期所形成的临时补充流动资金。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 11.99 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2022 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 12.49 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2023 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 8.50 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2024 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事及保荐机构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5.50 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种

等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2025年3月6日，公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经保荐机构发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5.20亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等保本型产品。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

根据前述审议情况，公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放，未投资相关产品。截至2025年9月30日，本年度以协定存款方式存放的存款利息是1,033,273.67元，累计以协定存款方式存放的存款利息是69,730,086.14元。

（六）剩余募集资金的使用计划和安排

截至2025年9月30日，公司尚未使用募集资金余额475,275,500.67元，其中存放于募集资金专户余额175,275,500.67元、用于临时补充流动资金300,000,000.00元，占募集资金总额23.00%，该剩余募集资金将根据项目进度陆续投入。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目是在原有研发中心的基础上，通过配备一系列先进研发、检测、实验和试验设备，引进一批高级技术人才，投入新产品、新工艺以及前瞻性项目的课题研究，进一步提升公司在产品开发、技术创新和性能测试等多方面的能力，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。

补充营运资金项目为公司补充流动资金，对缓解资金压力具有积极作用，使公司生产经营情况稳步健康发展，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺情况说明

东城工厂四期项目未达到预计效益的原因主要如下：

1、2023年和2024年未实现预期效益的原因：受全球宏观经济景气度不佳，通信网络领域市场需求下滑等因素影响，印制电路板行业出现阶段性低迷、行业竞争加剧、公司部分主要客户需求下降，通信网络类产品订单减少，产能释放进度及产品售价低于预

期。公司综合研判各应用领域的情况，在保持原通信网络领域产品外，开始调整产品结构，逐步导入汽车电子以及服务器领域的产品。但整体产能释放进度、产品售价未达预期，因此 2023 年和 2024 年项目实际效益未达预期。

2、2025 年 1-9 月实现预期效益原因：2025 年 AI 服务器市场需求爆发，服务器订单大幅增长，项目产能充分释放，且总体售价超过预期，使得 2025 年 1-9 月的项目效益达到承诺效益。

综上所述，虽然 2025 年 1-9 月东城工厂四期项目已实现预期效益，但无法覆盖 2023 年以及 2024 年因市场需求进行产品结构调整导致效益不及预期缺口，因此东城工厂四期项目的累计效益未达预期。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金投资项目实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披露，前次募集资金投资项目实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份情况。

六、前次募集资金使用的其他情况

无其他需要说明的情况。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：生益电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		206,624.09			已累计使用募集资金总额			156,939.13	
变更用途的募集资金总额		63,786.54			各年度使用募集资金总额				
					其中：2021 年度			69,463.07	
					2022 年度			41,678.07	
					2023 年度			21,212.60	
					2024 年度			3,889.70	
变更用途的募集资金总额比例		30.87%			2025 年 1-9 月			20,695.69	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目									
东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	103,335.19	103,335.19	105,815.30	103,335.19	103,335.19	105,815.30	2,480.11[注 2]	2022 年 12 月
吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目		63,786.54			63,786.54				变更取消[注 1]
	智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期[注 1]		63,786.54	20,695.69		63,786.54	20,695.69	-43,090.85	2025 年 12 月
研发中心建设项目	研发中心建设项目	10,423.29	10,423.29	10,460.06	10,423.29	10,423.29	10,460.06	36.77[注 2]	2023 年 12 月
补充营运资金项目	补充营运资金项目	19,948.88	19,948.88	19,968.07	19,948.88	19,948.88	19,968.07	19.19[注 2]	不适用

合计	--	197,493.90	197,493.90	156,939.12	197,493.90	197,493.90	156,939.12	-40,554.78	--
----	----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----

注 1：公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”的募集资金全部变更用于“智能算力中心高层高密互连电路板项目一期”。2025 年 5 月 12 日，公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过了上述变更募集资金投资项目的议案。详见本报告之“二、（二）、4”。

注 2：“东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”截至期末累计投入金额超过 100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：生益电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益金额	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-9 月		
东城工厂（四期）5G 应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	78.07%[注 1]	126,309.67[注 2]	建设期	-3,211.25	7,567.25	49,354.39	53,710.39	否[注 3]
智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用[注 4]
研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]
补充营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]

注 1：“截止日投资项目累计产能利用率”系指投资项目达到预计可使用状态后至截止日期间。

注 2：东城工厂四期项目达到预定可使用状态为 2022 年 12 月，其累计承诺效益计算期间为 2023 年 1 月至 2025 年 9 月，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：受全球宏观经济景气度不佳、通信网络市场需求下滑等因素影响，公司通信网络领域订单减少，产能释放进度及产品售价低于预期，为应对市场变化，公司逐步导入汽车电子、服务器产品提高产能利用率、改善效益，但整体产能释放进度、产品售价未达

预期，致使东城工厂四期募投项目的累计实现效益未达预期。详见本报告三、（三）。

注 4：智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期截至 2025 年 9 月 30 日仍处于建设期，尚未产生效益。

注 5：研发中心建设项目、补充营运资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。详见本报告三、（二）。